**证券代码：688521 证券简称：芯原股份**

**芯原微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √ 特定对象调研 □ 分析师会议  □ 媒体采访 □ 业绩说明会  □ 新闻发布会 □ 路演活动  □ 现场参观 □ 电话会议  □ 其他（ ） |
| **参与单位名称** | 2023年9月5日  Abu Dhabi Investment Authority、Allianz Global、AnglePoint Asset Management、Brilliance Capital Management、Teng Yue Partners等 |
| **时间** | 2023年9月5日 |
| **调研方式** | 线下会议 |
| **公司接待人员姓名** | 公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）  公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | |
| **公司介绍** | 芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP共六类处理器IP、1,500多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。  芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现5nm系统芯片（SoC）一次流片成功，多个5nm一站式服务项目正在执行。此外，根据IPnest在2022年的统计，从半导体IP销售收入角度，芯原是中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的IP种类排名前二。  2023年上半，公司实现营业收入11.84亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2,221.76万元， 较去年同期提739.52万元，增幅为49.89%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为209.26万元， 较去年同期提升1,552.29万元。 |
| **交流问答** | **问题：请问公司有哪些IP技术可以获益于现在的AI趋势？**  回复：在人工智能领域，公司目前拥有NPU、高性能GPU、GPGPU、AI GPU子系统等各类产品组合，我们既可以满足生成式AI在云端训练、在边缘端推理的计算要求，也可以广泛赋能从云到端的、各种设备的智能化升级。  在AIoT领域，芯原用于人工智能的神经网络处理器IP（NPU）业界领先，已被68家客户用于其120余款人工智能芯片中。这些内置芯原 NPU 的芯片主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等十余个市场领域。  芯原GPU IP已经耕耘嵌入式市场近20年，在多个市场领域中获得了客户的采用，包括数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC等。芯原GPU还可以和自有的NPU融合，支持图形渲染、通用计算以及AI处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器提供大算力通用处理器平台。在此GPU IP研发基础上，公司的GPGPU可以支持大规模通用计算和生成式AI（AIGC）相关应用，现已被客户采用部署至可扩展Chiplet架构的高性能人工智能（AI）芯片，面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。  **问题：请问公司未来的IP发展规划是怎样的？**  回复：通过多年的技术研发积累，芯原目前已拥有六大处理器IP、1,500多个数模混合IP和射频IP，IP齐备程度很高，各IP的市场竞争力也非常强。随着市场和行业的发展，我们原有的IP会持续根据客户和市场需求迭代，在此基础上，我们也会根据技术和市场发展趋势，结合公司自身的优势，有计划地丰富公司的IP版图，多个IP行成“组合拳”来更好地满足不同场景下的客户需求。  目前，我们已推出了基于半导体IP的平台授权业务模式，这种授权平台通常含有公司的多个IP产品，例如芯原的NPU IP可以结合芯原其他处理器IP，支持多种应用场景的人工智能升级发展，目前，我们的AI-ISP系列已经广泛获得了手机、机器视觉相关应用客户的青睐。类似的AI-Video技术、AI和GPGPU的结合等等，都已有相关行业龙头客户采用。  **问题：请问如何展望未来公司在Chiplet领域的发展？**  回复：Chiplet是半导体行业的重要发展趋势之一，芯原这几年来一直在致力于Chiplet技术和产业的推进，通过“IP芯片化，IP as a Chiplet”和“芯片平台化，Chiplet as a Platform”，来实现Chiplet的产业化。芯原作为大陆排名第一、全球排名前七的半导体IP供应商，拥有丰富的处理器IP核，以及领先的芯片设计能力，加上我们与全球主流的封装测试厂商、芯片制造厂商都建立了长久的合作关系，所以非常适合推出Chiplet业务。  UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）互联标准对Chiplet的发展具有重要的推动作用，芯原已经成为了大陆首批加入UCIe联盟的企业之一。随着Chiplet接口在行业内逐渐统一，以及封装技术逐渐成熟，芯原正在不断推进相关项目发展，目前，针对智慧出行、数据中心等市场需求，芯原正在从Chiplet芯片架构创新、支持UCIe国际标准的接口IP等方面入手，持续推进Chiplet相关项目发展。 |